

財團法人金屬工業研究發展中心 函

地址：811高雄市楠梓區高楠公路1001號

聯絡人：陳怡潔

電話：07-3513121 #2368

電子郵件：chieh@mail.mirdc.org.tw

236

新北市土城區中華路1段36號4樓

受文者：台灣區表面處理工業同業公會

發文日期：中華民國115年6月2日

發文字號：金企字第1150006924號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：115年可讓與專利說明、115年可讓與專利清冊

主旨：本中心辦理可讓與專利推廣，惠請轉知所屬會員，請查照。

說明：

一、本中心將擁有之29件優質專利，以讓與之方式提供國內企業，期能增加企業國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

二、針對可讓與專利請詳參附件，或至金屬中心官網產業服務技轉園地(<https://www.mirdc.org.tw>)提供更多詳細專利資訊參考，意者歡迎洽詢本案聯絡人。

正本：臺灣手工工具工業同業公會、台灣風力發電產業協會、台灣區表面處理工業同業公會、台灣區金屬品冶製工業同業公會、台灣區造船工業同業公會、台灣區金屬資源再生工業同業公會、台灣區動力機械工業同業公會、台灣區造船工業同業公會、台灣區彈簧工業同業公會、台灣區鑄造品工業同業公會、台灣區鑄造學工業同業公會、台灣區農機工業同業公會、台灣區電線電纜工業同業公會、台灣區鐘錶工業同業公會、台灣區鍛造工業同業公會、台灣區鑄造學工業同業公會、台灣區螺絲工業同業公會、台灣區鉚接工業同業公會、台灣區機械工業同業公會、台灣區輕金屬協會、台灣區發展協會、台灣區雷射工業同業公會

副本：

台灣區表面處理工業同業公會		
收文	115/04	號
民國	115年	6月4日

董事長 劉嘉茹

本案依照分層負責授權主管決行

裝

訂

線

印章

115年讓與標的說明(列表)

專利名稱	申請國家	專利證號
ELECTRONIC CASING AND METHOD of MANUFACTURING THE SAME	美國	US8,020,423B2
ELECTRONIC CASING AND METHOD of MANUFACTURING THE SAME	韓國	10-1133814
壓電夾持裝置	中華人民共和國	ZL200710306346.4
輥輪導正裝置	中華民國	I348941
PRESTRESS-ADJUSTABLE PIEZOELECTRIC GRIPPING DEVICE	美國	US7,855,491B2
音叉式接觸感測裝置及其感測方法	中華民國	I404921
滾輪式微接觸印刷裝置及其印刷方法	中華民國	I410332
滾輪式微接觸印刷裝置及其印刷方法	美國	US8,991,314B2
真空抽氣系統及其節流閥	中華民國	I472695
扭力板手	中華民國	I395641
根管阻塞物移除器具	中華民國	I387446
根管阻塞物移除器具	中華民國	ZL201110228155.7
ALIGNMENT METHOD FOR ASSEMBLING SUBSTRATES WITHOUT FIDUCIAL MARK	美國	US8,644,591B2
薄膜網版印刷系統及方法	中華人民共和國	ZL201110395959.6
高靈敏真空動力引入裝置及真空製程設備	中華民國	I495812
線性翻轉機構及真空設備	中華民國	I492893
線性翻轉機構及真空設備	中華人民共和國	ZL201310642795.1
光學影像擷取模組、對位方法及觀測方法	中華民國	I448659
光學影像擷取模組、對位方法及觀測方法	中華民國	I456163
光學影像擷取模塊、對位方法及觀測方法	中華人民共和國	ZL201310522035.7
鍍膜設備	中華民國	I495748
鍍膜設備	中華民國	I521153
真空線性機械引入裝置	中華民國	I534287
化學氣相沉積鍍膜連續鍍製裝置	中華民國	I534292
高均勻化學氣相沉積鍍膜連續鍍製裝置	中華民國	I553145
化學氣相沉積鍍膜連續鍍製裝置	中華民國	D184614
電動手工具	中華民國	M549619
外骨骼輔助裝置	中華民國	I680842
醫療用扭力手工具裝置	中華民國	DE202019106597
MEDICAL TORQUE HAND TOOL	德國	

專利技術類別與可應用領域對應圖

依 29 件專利之技術內容進行分類，對應可延伸之應用市場與產業方向。

專利總數
29 件



1. 組裝、對位與封裝技術

3 件

代表技術：

ELECTRONIC CASING AND METHOD
OF MANUFACTURING、ALIGNMENT
METHOD FOR ASSEMBLING SUBSTRATE

可應用領域

- 半導體封裝
- 基板對位
- 電子組裝
- 自動化組裝



2. 精密機構與工具設計

7 件

代表技術：

壓電夾持裝置、輾輪導正裝置、
PRESTRESS-ADJUSTABLE PIEZOELECTRIC
GRIPPING、扭力扳手、電動手工具

可應用領域

- 精密機械
- 自動化設備
- 夾治具
- 設備零組件
- 工具機



3. 製程設備與真空系統

4 件

代表技術：

真空抽氣系統及其節流閥、
高靈敏真空動力引入裝置及真空製程設備、
線性翻轉機構及真空設備

可應用領域

- 真空製程
- 顯示器製造
- 半導體設備
- 智慧製造設備



4. 光學感測與檢測技術

4 件

代表技術：

音叉式接觸感測裝置及其感測方法、
光學影像擷取模組、對位方法及觀測方法

可應用領域

- 光學檢測
- 精密量測
- AOI
- 智慧感測
- 自動對位



5. 材料、薄膜與印刷製程

6 件

代表技術：

滾輪式微接觸印刷裝置及其印刷方法、
薄膜網版印刷系統及方法、化學氣相沉積
鍍膜連續鍍製裝置、高均勻化學氣相沉積
鍍膜連續鍍製裝置

可應用領域

- 薄膜沉積
- 電子材料
- 表面處理
- 半導體 / 顯示製程
- 印刷電子



6. 醫療器材與復健輔具

5 件

代表技術：

根管阻塞物移除器具、外骨骼輔助裝置、
醫療用扭力手工具裝置、
MEDICAL TORQUE HAND TOOL

可應用領域

- 牙科器械
- 醫療手工具
- 手術工具
- 智慧醫材
- 復健輔具



應用面向涵蓋：半導體與電子製造、精密機械、自動化設備、光學檢測、材料鍍膜、醫療器材。

註：部分專利可跨領域應用，分類依主要技術內容歸納。

